

第 54 回定時株主総会 事前質問に対する回答及び質疑応答

当資料は、2026 年 3 月 24 日（火）に開催した当社第 54 回定時株主総会において、株主の皆様から事前および当日にいただいた主なご質問と、その回答を要約したものです。

【事前質問へのご回答】

質問①：現在、先端パッケージ向け装置の引き合いが急増しているとのことですが、御社の PLP 向け装置については、正式な受注・売上として業績に寄与してくるのは、いつごろでしょうか。

回答①：チップサイズの拡大に伴い、ウェハサイズから 300 mm 角を越えるパネルサイズへの転換に伴い、PLP 対応装置の引合いは急増しておりますが、現在、プロセスを含めた装置開発を進めており、業績への寄与につきましては 2027 年以降となる見通しです。

質問②：今期の設備投資に対し、14 億円という減価償却費が計上され、足元の利益を圧迫していると理解しています。来期以降、売上拡大とともに利益率が向上する「V 字回復のフェーズ」に入っていくという認識でよろしいでしょうか。

回答②：今期、デモ装置や開発機等の装置関連設備への投資額が多く、これらが減価償却費が増加する要因となっております。半導体業界全体は今後も継続的に成長する見通しであり、今期の設備投資の実施は、将来の業績拡大に向けた準備と考えるものであり、ご理解賜りたく存じます。

質問③：同業他社が PER30~40 倍で評価される中、御社が PER10 倍台前半に留まっている現状は、「市場への見せ方 (PR)」の差だと考えおります。この評価の乖離を是正するため、株主還元や IR の強化について、どのような具体策をお考えでしょうか。

回答③：ご指摘のように、「市場への見せ方」が十分ではないと認識しております。今後はタツモの技術力や将来性について皆様にご理解いただけるよう積極的に発信するとともに、個人投資家様向けの会社説明会などへの参加や、開示内容の充実を一層進めていきたいと考えております。また、株主還元につきましては、研究開発や設備投資など、将来の成長へ向けた投資も必要と考えており、株主様への還元とのバランスも考慮したうえで、安定的且つ確実な実施を目指していきたいと考えております。

【株主総会における質疑応答】

質問①：決算短信などを書いてある検収遅れについて、具体的に内容を知りたい。

回答①：半導体製造装置は、新しいプロセスや材料、デバイスに対応するための初号機（開発要素の高い装置）として受注・納入されるケースが多く、お客様と当社が共同で検証を進めながら立ち上げや性能確認を行います。その過程では、当初想定した性能が出ない、デバイスの製造工程が計画通りに構築できない、さらには前後工程の装置やプロセスに起因する問題が発生するなど、さまざまな要因により検収時期が遅延する可能性があります。実際に現在発生している検収遅延の多くも、このような初号機案件に起因しています。一方で、2台目以降のレポート性の高い装置については、検証が進んでいるため検収リスクは比較的低いと考えられます。

質問②：今後も検収遅れが発生する可能性について、教えて頂きたい。

回答②：今後も当社としては新規性の高い装置開発に積極的に取り組んでいく方針であるため、リスク低減に努めつつも、一定の検収遅延リスクは引き続き存在すると認識しています。

質問③：PLP に関して、2027 年ぐらいから供給本格化していくとのイメージでよいか

回答③：AI 半導体の高性能化に伴いチップサイズが大型化しており、従来の 300mm ウェハでは生産性に限界があることから、パネルへの移行が進んでいます。今後、AI の高度化と普及により、大型パネルパッケージ市場は拡大し、特に 2027 年以降はさらに成長が見込まれます。加えて、PLP は高性能デバイスだけでなく、500mm や 600mm といったより大きなパネルを用いた量産用途にも広がり、民生品向け市場への展開も進む見込みです。当社はこれらの動きを捉え、これまでの知見を活かして市場拡大に合わせた装置投入を進めていく方針です。

質問④：PLP と薄化の関連性はあるのか。タツモの事業にとってどのように成長に繋がっていくのか。

回答④：薄化と PLP は密接に関係しており、PLP は複数の半導体チップをパネル上に載せて積層する技術です。ここで用いられるチップは、ウェハを薄化した後に切り出されたもので、現在では非常に薄いデバイスも登場しています。そのため、PLP 市場が拡大するほど、その上に搭載される薄化ウェハチップの需要も増加する関係にあります。また、PLP ではメモリやロジック、通信用デバイスなど多様なチップを組み合わせて積層するため、さまざまな種類の半導体が使われる点も特徴です。

質問⑤：PLP は規格化・標準化が進んでいくのか。進んでいく場合に何かボトルネックがあるのか。

回答⑤：パネルレベルパッケージ（PLP）の規格化が進む中で、ビジネスへの影響としては、従来の 300mm ウェハ向け装置に加え、パネル対応装置の需要が高まり、新たな設備投資やライン構築の引き合いが増えている点が挙げられます。当社としてもこれは売上拡大の好機と捉え、積極的に対応を進めています。一方で、規格が数種類に集約され標準化が進むことで、デバイスメーカーにとってはコスト低減やライン構築の容易化につながりますが、装置メーカー側では開発費を抑えられる反面、競争は一層激化します。そのため、初期の開発・量産ラインへの採用を確実にすることが重要であり、研究開発への積極的な取り組みが今後の事業拡大の鍵になると考えています。

質問⑥：今期の設備投資 70 億円は井原の土地取得に関するものか、将来償却対象となるものなのか。

回答⑥：今期の 70 億円の内訳は、井原の土地取得やデモ装置の製造、加えて台湾での不動産や設備投資を見込んでおり、主に井原および台湾における土地・不動産の取得を中心とした投資を計画しています。

質問⑦：70 億円と非常に大きな設備投資を今回計画しているが、今まででの設備投資との違いはどこにあるのか。

回答⑦：今回の 70 億円という大規模な設備投資の特徴は、今後の事業拡大に向けた基盤強化にあります。まず井原の新工場用土地取得は、分散している既存工場を見直し、ものづくり改革を推進する拠点として、競争力の高い生産体制を構築することが目的です。3 年前から進めている改革を具現化し、高度な製造体制を実現する重要な投資と位置付けています。また台湾への設備投資については、売上の相当割合を占め、100 台以上の装置が稼働する重要市場であることから、拠点拡張によりサービス、研究開発、顧客対応力を強化し、現地での事業拡大を図る狙いがあります。今回の投資は、国内外での競争力強化と成長基盤の確立を目的とした重要な取り組みです。

質問⑧：これだけの設備投資をする時の監督、ガバナンス体制はどうか。社外取締役の中には半導体業界の知見を有している方がいないようであるが、どのように議論に参加し、どのようなリスクを認識し判断されているか伺いたい。

回答⑧：社外取締役の関与については、2025 年に開催された取締役会（全 14 回）すべてに参加いただき、毎回それぞれの経験や実績に基づく貴重な意見を得ています。個別の発言内容は控えますが、大規模投資や新設備についてもガバナンスの観点から適切に議論されています。また、社外取締役は半導体業界の専門知識は必ずしも有していないものの、社内取締役や執行役による専門的な検討に加え、外部アドバイザーの知見も活用しながら補完しています。その上で、社外取締役からは外部視点に基づく有益な助言を得ており、意思決定の質向上に寄与している状況です。

質問⑨：新人の採用・育成について、この売り手市場の中でどのように対応しているのか。その取り組みにより定着率が以前と比べてどう変わってきているのか。

回答⑨：新入社員の採用については、本社移転以降、先端技術分野への取り組みやプライム市場上場企業である点、岡山という地域性も背景に、新卒・キャリアともに順調に進んでおり、大きな課題はないと認識しています。育成面では、人的資本経営の観点から、本社移転後に人材開発プロジェクトを立ち上げ、新入社員教育を中心に毎年プログラムを改善しながら継続的に強化しています。加えて、シニア層の活用や若手・中堅・管理職層の育成についても議論と施策を進めています。また、エンゲージメント調査を通じて職場環境の改善にも取り組んでおり、その結果、自己都合退職率は 1.6%と低水準を維持しています。今後も育成・定着の強化を図っていく方針です。

質問⑩：イランの紛争におけるホルムズ海峡封鎖の影響はどうか。予想外の事態についてどのように対処していくのか。

回答⑩：今回の紛争に伴うリスクについて、当社は部品調達に依存するビジネスであるため、調達状況が重要なポイントとなります。現時点では一部部品で供給遅延の懸念やメーカーからの事前アナウンスはあるものの、影響は限定的で事業全体への大きな影響はないと認識しています。一方で、コロナ禍における調達難の経験を踏まえ、現在は調達先の多様化を進め、国内外に分散したサプライチェーンを構築しています。これにより、今回のような地政学リスクにも柔軟に対応できる体制を整えており、今後もリスク分散を図っていく方針です。

質問⑪：池田会長、佐藤社長の役割分担はどうか。今後どれくらい今の体制を続けていくのか。

回答⑪：社長就任から3年間、一貫して自身が前面に立ち、方針を主導する体制で経営を進めてきました。今後もこの基本方針は変えず、自らの考えに基づく取り組みを推進していきます。一方で、顧客対応や対外折衝、社内組織運営などにおいては、これまで池田会長から多くの助言を得てきており、今後も重要な場面でアドバイスを受けながら経営を進めていく方針です。

質問⑫：池田会長が社長であった2011年からの12年間ほどは振り返ってみて、どういう期間であったか。どういった経営をされていたか。これから佐藤社長がどのように経営していかれることを期待しているか。

回答⑫：かつて特定顧客への依存から脱却し、自立した企業になるため「下請けでは成長できない」との考えで経営改革を進め、社員とともに困難を乗り越えて現在に至りました。一方で、当時は十分にできなかった社員教育の重要性を認識しており、現在は佐藤社長が人材育成の充実に取り組んでいる点を高く評価しています。今後は教育を通じた内部体制の強化が事業成長の鍵であり、さらなる発展に期待しています。

質問⑬：中期経営計画について方針を伺いたい。中期経営計画は作成中なのか。

回答⑬：中期経営計画については、3年前に公表した計画をベースとしつつ、現在は開示を停止しています。その背景には、半導体業界の変化が激しく数値目標が短期間で見直しを余儀なくされてきたことや、数値だけでは経営の考え方や方向性が十分に伝わらないという課題があります。このため、一昨年より中長期の経営の在り方を見直し、新たなビジョンやミッション、今後の取り組み方針を整理するプロジェクトを進めています。今後はこれらを明確にした上で開示し、それに基づいて事業拡大を図る方針です。引き続き、変動の大きい半導体業界の中でも新しい分野や生産ライン、デバイスへの取り組みを強化し、新たなビジョン・ミッションを軸に成長を目指していく考えです。

以上